

財團法人工業技術研究院 函

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：林宜萱

電話：03-5918290

E-mail：itri536277@itri.org.tw



1120016078017

2366623666 新北市土城區中華路 1 段 36 號 4 樓

受文者：台灣區表面處理工業同業公會

發文日期：中華民國 112 年 07 月 25 日

發文字號：工研轉字第 1120016078 號

速別：普通件

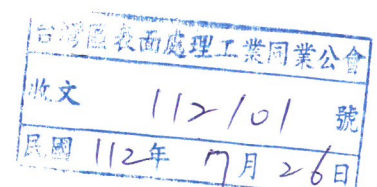
密等：無

附件：如文


主旨：本院擬舉辦「112 年無形資產融資媒合會」，茲檢送活動簡章，敬請貴單位協助公告並鼓勵會員等相關企業踴躍報名本次推廣活動，請查照。

說明：

- 一、工業技術研究院(以下簡稱「工研院」)受經濟部工業局委託執行「智慧財產價值躍升計畫」，旨在完善無形資產流通運用之生態系統，為鼓勵國內新創、中小企業活絡無形資產之運用，透過「無形資產融資」專案，鏈結企業之優質專利/技術與銀行資金，促進新興技術落實產業之發展。
- 二、工研院於 112 年 10 月 13 日辦理「112 年無形資產融資媒合會」，敬邀各位中小企業先進把握機會參加本次活動，與各家銀行代表交流。
- 三、活動簡章及報名方式詳參附件，請於 112 年 9 月 15 日前完成報名，名額有限，額滿將不再受理。
- 四、聯絡人：工研院技轉法律中心 林小姐/電話 03-5918290/
電子信箱 itri536277@itri.org.tw



正本受文者：台灣區表面處理工業同業公會

院長 

依本院權責劃分規定授權業務主管執行

112年無形資產融資

企業 x 銀行 媒合會

112/10/13
09:30-12:00 **五**

- 工業技術研究院受經濟部工業局委託執行「智慧財產價值躍升計畫」，旨在完善無形資產流通運用之生態系統。為鼓勵國內新創、中小企業活絡無形資產之運用，透過「專利融資評價」專案，鏈結企業之優質專利與銀行資金，促進新興技術與無形資產評價產業之發展。

活動地點 臺北市信義路五段5號(世貿展覽館)第3會議室

活動議程

報名
即日起至
9/15
截止

09:30-09:50 簽到

09:50-10:10 **無形資產融資機制說明**
工業技術研究院 技轉法律中心 曾士恒專案經理

10:10-10:25 **無形資產融資銀行實務分享**
上海商業儲蓄銀行西湖分行 嵇彭志經理

10:25-10:35 **無形資產融資企業經驗分享**
萊鎂醫療器材(股)公司 陳仲竹執行長

10:35-11:00 創新技術發表

11:00-12:00 企業與銀行交流時間

活動全程免費，名額有限，敬請把握。

報名連結：<https://forms.gle/SvCth2EgoC53zjMa7>

或 掃描右方QR Code立即報名！



活動報名問題請聯絡：林小姐 / 03-5918290 / itri536277@itri.org.tw

